

標準仕様一覧

項目	詳細	標準仕様	特別仕様	備考
材料	基材	FR-4 CEM-3 FR-1	ハロゲンフリー材 ホリイミド PPE テフロン	FR4材料多層材通常在庫品 プリプレグ・R1661 t0.06 t0.1GG t0.2GB t0.2GG コア材・R1766 t0.06 t0.1 t0.2 t0.3 t0.8 t0.9 t1.0 プリプレグ・R1551 t0.06 t0.1GG t0.2GG コア材R1566 t0.1 t0.2 t0.3 t1.0
	銅箔厚(外層)	18,35, μ m	12,70,105,200 μ m	
	銅箔厚(内層)	35 μ m	18,70 μ m	
最大製品サイズ	～2層	485×485mm	485×585mm	
	4層	390×465mm	480×585mm	
	6層～	385×465mm	480×585mm	
板厚	1層	0.5～1.6mm		基材による
	2層	0.4～2.0mm	0.1～3.2mm	
	4層	0.5～2.4mm	～3.2mm	
	6層	0.7～2.4mm	～3.2mm	
	8層	1.0～2.4mm	～3.2mm	
	10層	1.2～2.4mm	～3.2mm	
	12層	1.4～2.4mm	～3.2mm	
最小穴径(ドリル径)	板厚～1.2mm	Φ0.2mm	Φ0.15mm	ドリル径※仕上がりは-0.05mm
	板厚1.6mm	Φ0.25mm	Φ0.2mm	アスペクト比 標準仕様 板厚÷穴径＝6程度目安
	板厚2.0mm	Φ0.3mm	Φ0.25mm	アスペクト比 特別仕様 板厚÷穴径＝8以上目安 ※10以上は別途ご相談
最大穴径	スルホール径	Φ6.0mm	Φ6.0以上	
最小ランド径	外層(部品穴)試作	穴径+0.4mm	穴径+0.25mm	穴径＝仕上がり径 ※ドリルは+0.1mm使用 ※ドリル+0.05mm使用の場合:左記のランド径より-0.05mm可 ※フラットTHの場合:穴径+0.1mm可(穴径＝ドリル径とする)
	外層(導通穴)試作	穴径+0.3mm	穴径+0.25mm	
	外層(部品穴)量産	穴径+0.5mm		
	外層(導通穴)量産	穴径+0.4mm		
最小L/S	35 μ (メッキなし)	0.1/0.1mm	0.075/0.075mm	一部0.05/0.05mmも可 一部0.05/0.05mmも可
	70 μ (メッキなし)	0.2/0.2mm	0.15/0.15mm	
	12 μ +メッキ	0.1/0.1mm	0.075/0.075mm	
	18 μ +メッキ	0.15/0.15mm	0.08/0.08mm	
	35 μ +メッキ	0.2/0.2mm	0.12/0.12mm	
	70 μ +メッキ	0.3/0.3mm	0.2/0.2mm	
	105 μ +メッキ	0.4/0.4mm		
最小クリアランス	TH-パターン(内層)	0.25mm	0.2mm	0.2mm未満も可(要相談)
レジスト	クリアランス	0.05mm以上	0.025mm	特別
	残り幅	0.15mm以上	0.1mm	
	色	緑	白,青,黒,赤	
シルク	線幅	0.15mm以上	0.1mm	
	文字高さ	1.0mm以上	0.8mm	
	色	白	黄,黒,緑	
外形加工	スリット幅	1.5mm	0.8mm	0.8mm未満も可(要相談)
	Vカット角度	35度		
最小間隔	穴端-穴端	0.3mm	0.2mm	穴の大きさによる
	基板端-穴	1.0mm		
	基板端-パターン	外層0.3/内層0.5mm	外層0.2/内層0.4mm	
	Vカット-パターン	外層0.5/内層0.65mm		
フラットTH	板厚	0.6～1.6mm	0.1～6.0mm	※標準仕様:社内対応／特別仕様:外部工場対応 製造ワーク(製品面付け後)状態での穴数
	ドリル径	Φ0.15～Φ0.5mm	Φ0.1～Φ4.0mm	
	樹脂埋め穴数	1万穴未満	－	
	アスペクト比	5.3以下	1～40未満	
	印刷機	スクリーン印刷	真空印刷機	